ナノインプリントにおける離型力のモールド側壁傾斜角依存性 I

Dependence of de-molding force on sidewall slope angle of mold pattern in nanoimprint I ¹大阪府立大 院 工学研究科, ²ワルシャワ工科大 マイクロメカニクス・フォトニクス研 植村公亮¹,藤井一緒¹, Marcin Michalowski², 〇栩野貴充¹,中村直登¹,川田博昭¹, Zygmunt Rymuza²,平井義彦¹

Lygmunt Kymuza, 平开我多

¹Osaka Pref. Univ. Graduate School of Eng., Sakai, Japan ²Warsaw Univ. of Technology, Institute of Micromechanics and Photonics, Warszawa, Poland •Kimiaki Uemura¹, Kazuo Fujii¹, Marcin Michalowski², OTakamitsu Tochino¹, Naoto Nakamura¹, Hiroaki Kawata¹, Zygmunt Rymuza², and Yoshihiko Hirai¹

E-mail: hirai@pe.osakafu-u.ac.jp

<u>はじめに</u>) ナノインプリントにおける離型プロセスでは、レジスト破断などによる欠陥を防ぐため、離型 に要する離型力を抑える必要がある.ここでは、パターン側壁の傾斜角が、離型力に及ぼす影響を調べた.

<u>モールド作製</u>) ボッシュ法を用いて,Siのエッチングを 行い,モールドを作製した[1]. Fig.1 に示す様に,a)短時 間の側壁保護膜堆積する.b)次に保護膜と基板を同時に エッチングする.この時,過剰に堆積した保護膜がエッ ジ部に残存するため,中央部がエッジ部に比べエッチン グ深さが大きくなる.これを繰り返すことにより,傾斜 形状が得られる.この時,堆積/エッチング時間比を大き して堆積が過剰にする程,傾斜角 θ が小さくなる.Fig.2 に作製したモールドの断面 SEM 画像を示す.作製した



Fig.1. Side wall etching process: (a) Passivation layer deposition, (b) Si and passivation layer etching,

モールドを用いて、PMMA(Mw<120k)に対してナノインプリントを行い、離型力を測定した. <u>結果と考察</u>) Fig.3 に、傾斜角と離型力の関係を示す.傾斜角の減少に伴い離型力は低下する.この例で は、傾斜角が 80 度程度以下では離型力は変わらない結果となった.これは、剥離モードの変化が生じて いるためと考えられる.ここで、レジスト-モールド界面に加わる垂直ならびにせん断方向の応力(σ_n なら びに σ_s)が、臨界値($P_s P_n$)を超えたとき剥離が生じると仮定する[2]と、 $\sigma_n > P_n / \cos \theta$ もしくは $\sigma_s > P_s / \sin \theta$ の 時に剥離され、 $\sigma_n \sigma_s$ のいずれか小さい方が離型力に相当することになる. $P_s P_n を、摩擦力顕微鏡により$ $測定し、図中の実線に<math>\theta$ に対する離型力の相対的な依存性を示した.このモデルでは、 θ の減少に伴い離 型力は減少し続け、実験結果を十分に説明できない.これはモールドの上底面部分の影響と考えられる.







Fig.3 De-molding force in various side wall angles. (Dots and crosses: experiments, Solid line: analytic model, Ps:Pn=20:1)

[1] H. Kawata, et al., Jpn. J. Appl. Phys.49 (2010) 06GL15.

[2] M. Ortiz, et al., Int. J. Numer. Methods Eng. 44, (1999) 1267.